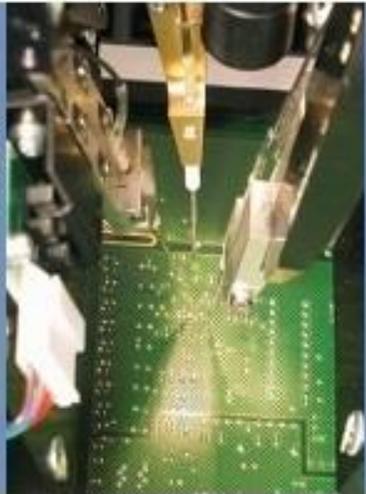


V810 5.13.4(18068) 软件版本 “或”算法插件使用说明



Solutions for Board Test
Agilent3070 ICT
Teradyne TestStation ICT
ViTrox AOI,AXI
TAKAYA Flying probe
Ceepel JTAG

Shanghai • Suzhou • Shenzhen • Hongkong

插件功能说明

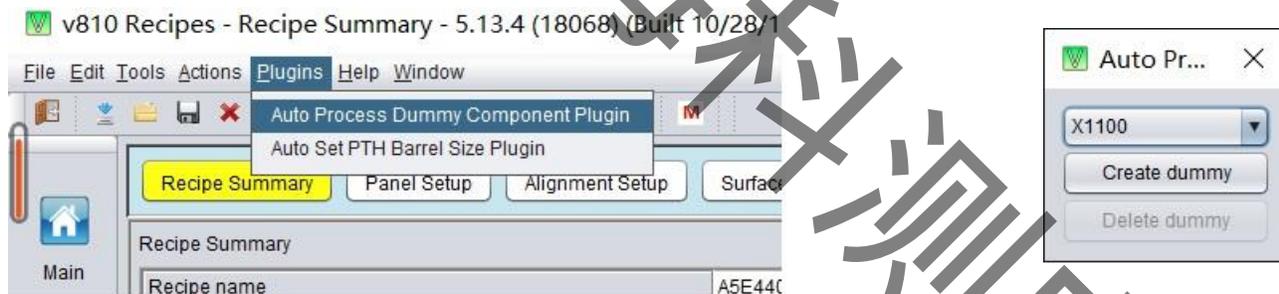
此功能是针对PCBA同一位置有两种不同物料会随机出现，为了减少误报、避免漏测而开发的一个“或”算法插件。

插件使用流程

1. 在原始程式中使用A物料的板子将程式完全调试OK
2. 针对会出现A, B物料混合使用的零件位置添加dummy零件
3. 针对dummy零件新建/修改subtype
4. 用使用B物料的板子重新收集图片对dummy零件的每一个subtype进行调试

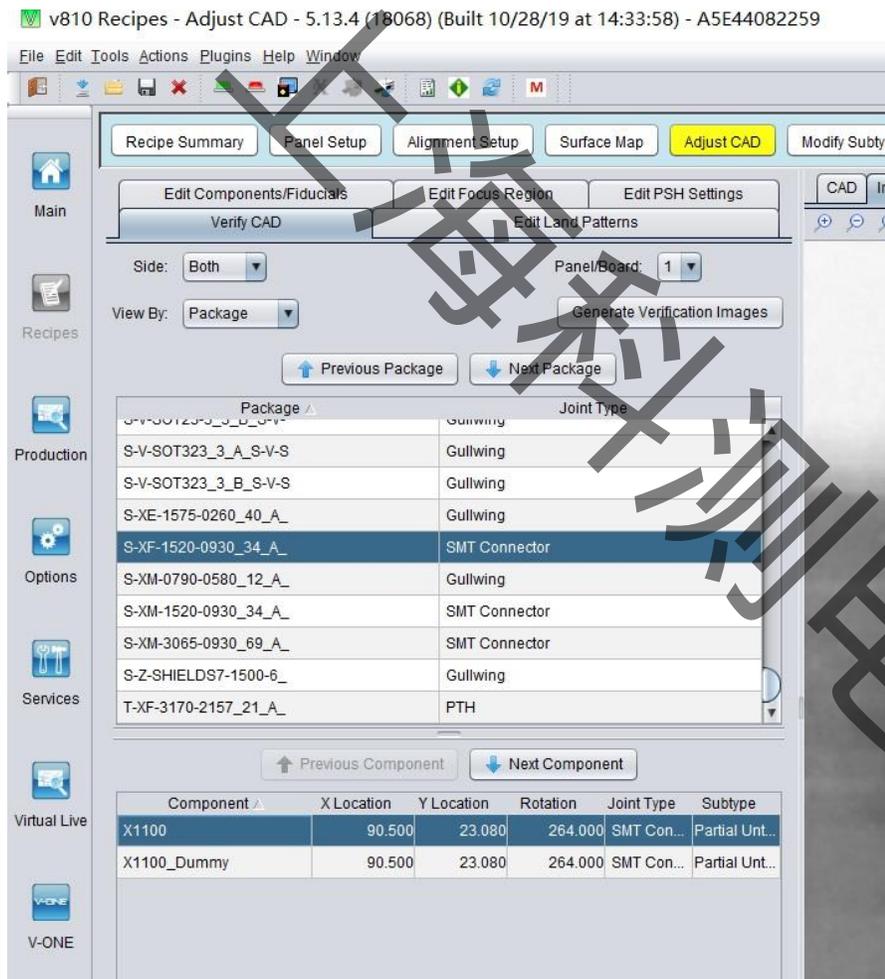
操作步骤

1. 在原始程式调试完成后在菜单里对有需要的零件逐一添加dummy零件
* (原始程式必须先调试好, 因为在增加dummy以后将不可以修改焊点上锡方向)



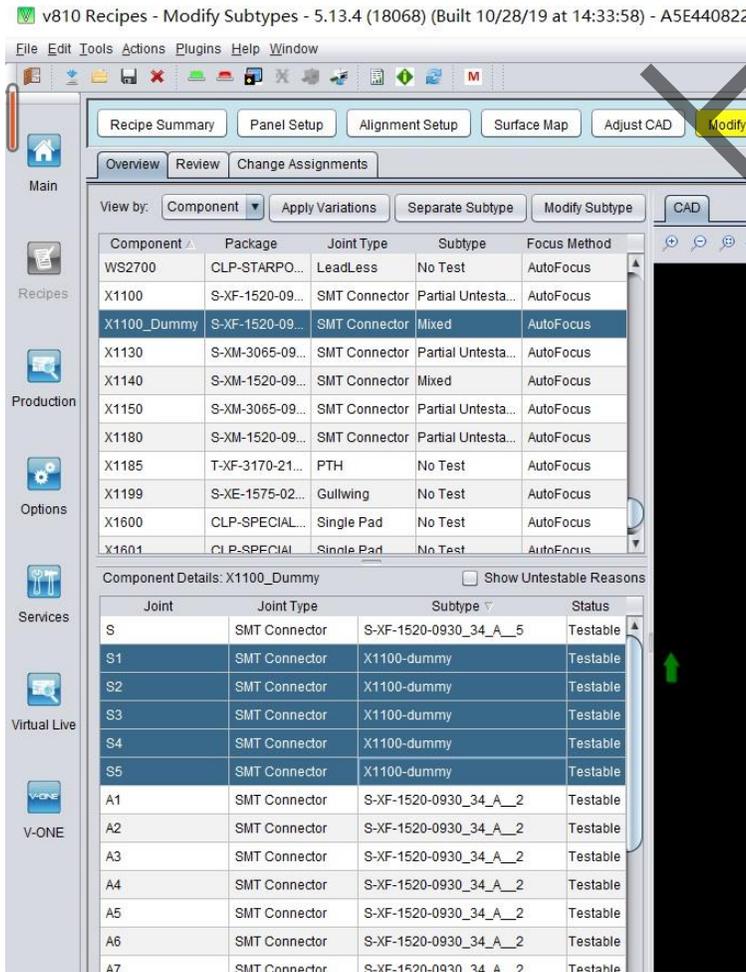
操作步骤

2. 添加dummy零件以后会生成以“_dummy”为后缀的镜像零件。



操作步骤

3. 在Modify Subtype里对每一个dummy零件修改subtype.

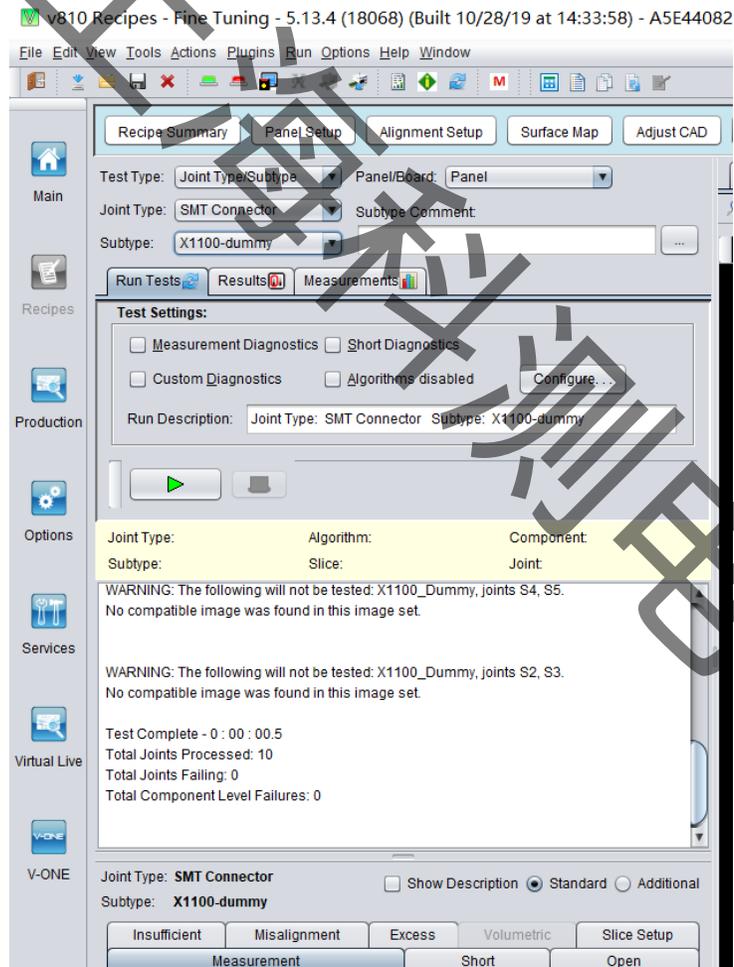


* 不同的subtype是实现“或”的关键，对同一零件使用两套不一样的参数就是在不同的subytype里.这里需要注意的有：

- 1.对有需要的焊点的每一类subtype均修改成不一样的subtype.
- 2.对不需要修改的焊点要保持和原始零件的subtype一致，不可以改为no test.
- 3.原始零件里设置为no test的焊点在这里也需要检查并改为no test.

操作步骤

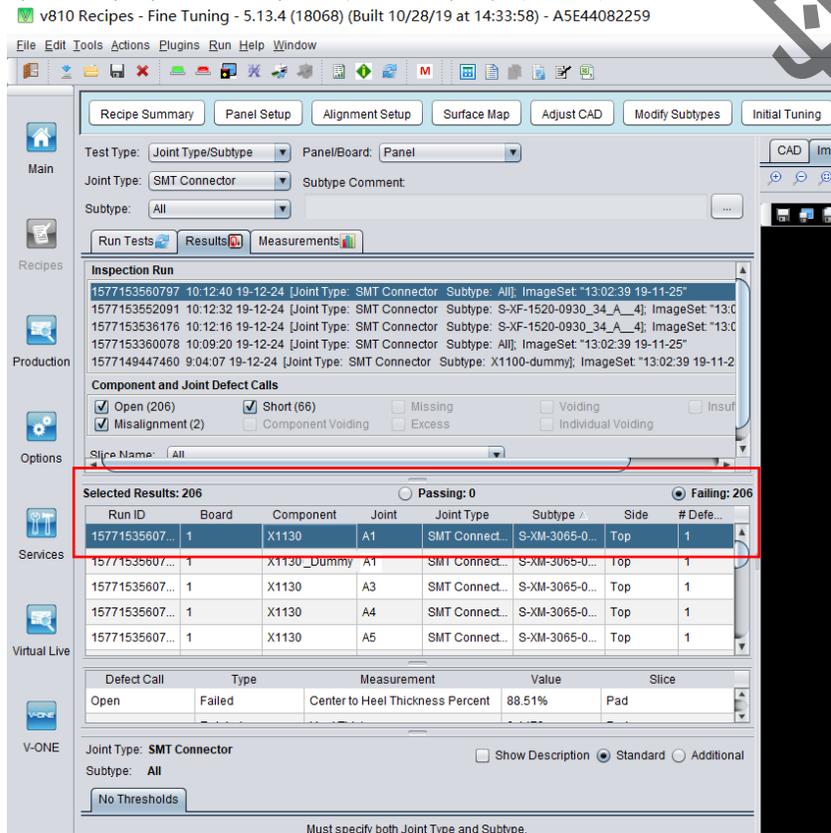
4. 修改完subtype后，用使用B物料的板子重新收集图片然后在Initial tuning和 Fine tuning 按正常步骤对dummy零件的里每一个新修改的subtype进行调试。



操作步骤

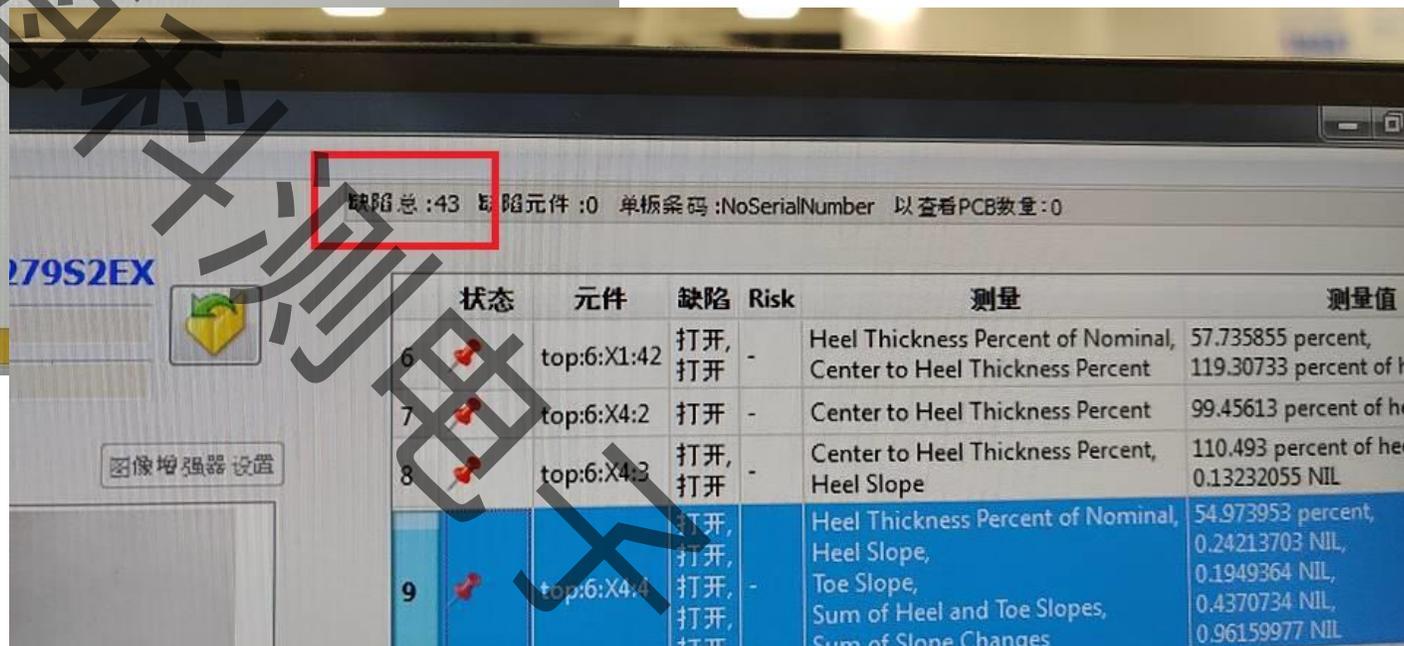
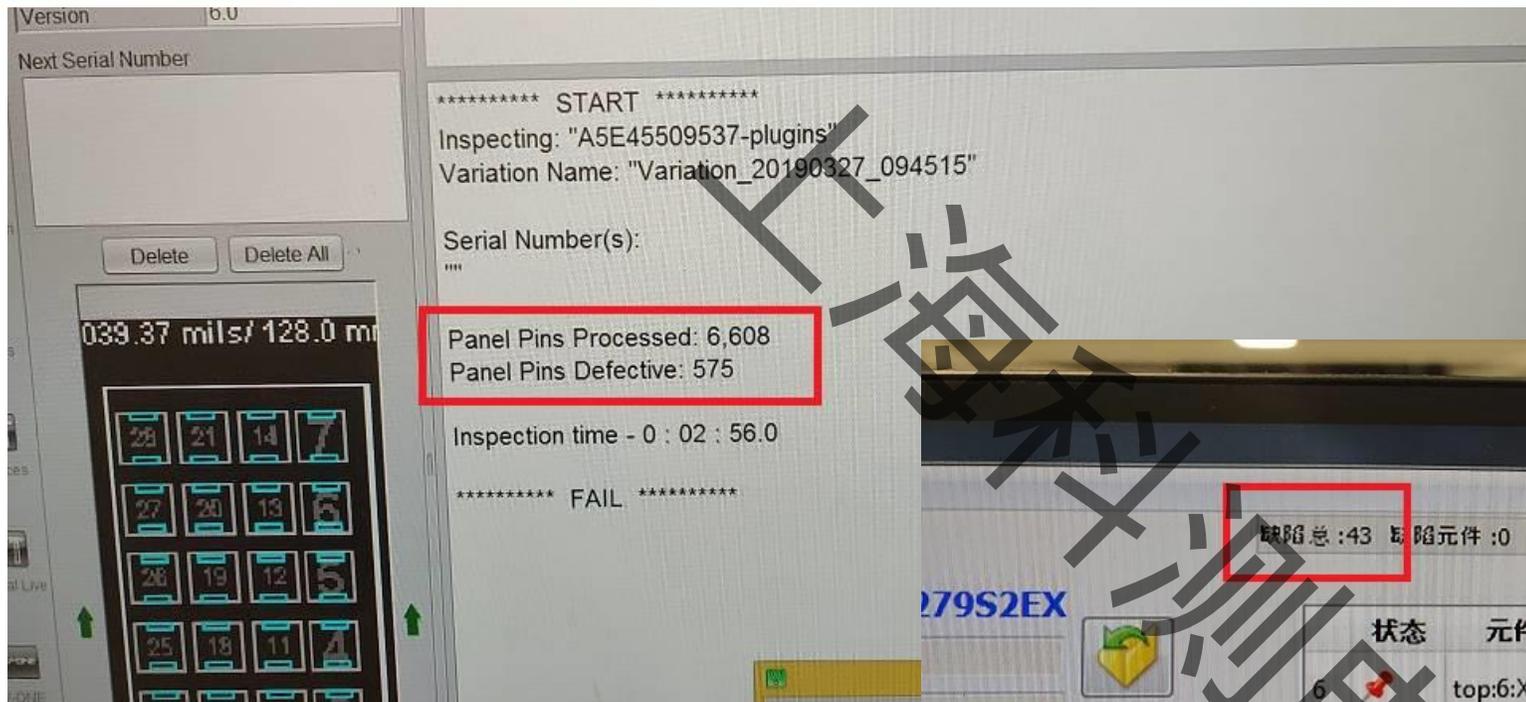
5. 调试完成后用使用A物料或B物料，或者A、B物料混合的板子验证。

*这里需要说明的是，“或”算法的实现是在测试完成后针对生成的测试结果处理来实现的，所以在调试界面的 results和测试主界面里看到的报错点数是没处理之前的结果并不是真正的报错点数，真正的报错点数需要在VVTS里查看。



*在调试界面的results里，只有当同一个零件的同一个焊点原始零件和“dummy”都报错时在最终的测试结果才是真正测试不良的点，才会导出测试结果去VVTS上。

操作步骤



THE END

谢谢!



Solutions for Board Test Agilent3070/Teradyne TestStation ICT/ViTrox AOLAXI/TAKAYA Flying probe | Goepel JTAG